

# E DIN EN ISO/IEC 15408-3:2024-03 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2024-02-16

Informationssicherheit, Cybersicherheit und Schutz der Privatsphäre -  
Evaluationskriterien für IT-Sicherheit - Teil 3: Sicherheit  
Gewährleistungskomponenten (ISO/IEC 15408-3:2022); Deutsche und Englische  
Fassung EN ISO/IEC 15408-3:2023

Information security, cybersecurity and privacy protection - Evaluation criteria for IT  
security - Part 3: Security assurance components (ISO/IEC 15408-3:2022); German  
and English version EN ISO/IEC 15408-3:2023

---

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	14
Vorwort.....	15
Einleitung.....	17
1 Anwendungsbereich.....	18
2 Normative Verweisungen.....	18
3 Begriffe.....	18
4 Übersicht.....	23
5 Paradigma für Vertrauenswürdigkeit.....	24
5.1 Allgemeines.....	24
5.2 Ansatz der Normenreihe ISO/IEC 15408.....	24
5.3 Ansatz für Vertrauenswürdigkeit.....	24
5.3.1 Allgemeines.....	24
5.3.2 Bedeutung von Anfälligkeiten.....	24
5.3.3 Ursachen von Anfälligkeiten.....	25
5.3.4 Vertrauenswürdigkeit der Normenreihe ISO/IEC 15408.....	25
5.3.5 Vertrauenswürdigkeit durch Evaluierung.....	25
5.4 Vertrauenswürdigkeitsskala der Normenreihe ISO/IEC 15408.....	26
6 Vertrauenswürdigkeitskomponenten.....	26
6.1 Allgemeines.....	26
6.2 Struktur der Vertrauenswürdigkeitsklassen.....	27
6.2.1 Allgemeines.....	27
6.2.2 Klassenname.....	27
6.2.3 Klasseneinleitung.....	27
6.2.4 Vertrauenswürdigkeitsfamilien.....	27
6.3 Struktur der Vertrauenswürdigkeitsfamilien.....	28
6.3.1 Familienname.....	28
6.3.2 Ziele.....	28
6.3.3 Komponentenebenen.....	29
6.3.4 Anwendungshinweise.....	29
6.3.5 Vertrauenswürdigkeitskomponenten.....	29
6.4 Struktur der Vertrauenswürdigkeitskomponenten.....	29
6.4.1 Allgemeines.....	29
6.4.2 Komponentenidentifikation.....	30
6.4.3 Ziele.....	30
6.4.4 Anwendungshinweise.....	30
6.4.5 Abhängigkeiten.....	30
6.4.6 Vertrauenswürdigkeitselemente.....	30

6.5	Vertrauenswürdigkeitselemente.....	31
6.6	Komponententaxonomie.....	31
7	<b>Klasse APE: Evaluierung des Schutzprofils (PP)</b> .....	<b>32</b>
7.1	Allgemeines.....	32
7.2	PP-Einleitung (APE_INT) .....	32
7.2.1	Ziele .....	32
7.2.2	APE_INT.1 PP-Einleitung.....	32
7.3	Konformitätsansprüche (APE_CCL).....	33
7.3.1	Ziele .....	33
7.3.2	APE_CCL.1 Konformitätsansprüche.....	33
7.4	Sicherheitsproblemdefinition (APE_SPD).....	36
7.4.1	Ziele .....	36
7.4.2	APE_SPD.1 Sicherheitsproblemdefinition.....	36
7.5	Sicherheitszielsetzungen (APE_OBJ).....	37
7.5.1	Ziele .....	37
7.5.2	Komponentenebenen .....	37
7.5.3	APE_OBJ.1 Sicherheitszielsetzungen für die Betriebsumgebung.....	37
7.5.4	APE_OBJ.2 Sicherheitszielsetzungen.....	38
7.6	Erweiterte Komponentendefinition (APE_ECD).....	39
7.6.1	Ziele .....	39
7.6.2	APE_ECD.1 Erweiterte Komponentendefinition.....	39
7.7	Sicherheitsanforderungen (APE_REQ) .....	40
7.7.1	Ziele .....	40
7.7.2	Komponentenebenen .....	40
7.7.3	APE_REQ.1 Sicherheitsanforderungen des PP-Moduls mit direkter Begründung.....	40
7.7.4	APE_REQ.2 Abgeleitete Sicherheitsanforderungen.....	41
8	<b>Klasse ACE: Evaluierung der Schutzprofilkonfiguration</b> .....	<b>43</b>
8.1	Allgemeines.....	43
8.2	Einleitung für PP-Module (ACE_INT).....	44
8.2.1	Ziele .....	44
8.2.2	ACE_INT.1 Einleitung für PP-Module.....	44
8.3	Konformitätsansprüche des PP-Moduls (ACE_CCL) .....	45
8.3.1	Ziele .....	45
8.3.2	ACE_CCL.1 Konformitätsansprüche des PP-Moduls .....	45
8.4	Sicherheitsproblemdefinition des PP-Moduls (ACE_SPD) .....	47
8.4.1	Ziele .....	47
8.4.2	ACE_SPD.1 Sicherheitsproblemdefinition des PP-Moduls .....	47
8.5	Sicherheitszielsetzungen des PP-Moduls (ACE_OBJ) .....	48
8.5.1	Ziele .....	48
8.5.2	Komponentenebenen .....	48
8.5.3	ACE_OBJ.1 Sicherheitszielsetzungen des PP-Moduls für die Betriebsumgebung.....	48
8.5.4	ACE_OBJ.2 Sicherheitszielsetzungen des PP-Moduls .....	49
8.6	Erweiterte Komponentendefinition des PP-Moduls (ACE_ECD) .....	50
8.6.1	Ziele .....	50
8.6.2	ACE_ECD.1 Erweiterte Komponentendefinition des PP-Moduls .....	50
8.7	Sicherheitsanforderungen des PP-Moduls (ACE_REQ).....	51
8.7.1	Ziele .....	51
8.7.2	Komponentenebenen .....	51
8.7.3	ACE_REQ.1 Festgelegte Sicherheitsanforderungen des PP-Moduls .....	51
8.7.4	ACE_REQ.2 Abgeleitete Sicherheitsanforderungen des PP-Moduls .....	53
8.8	Konsistenz des PP-Moduls (ACE_MCO).....	54
8.8.1	Ziele .....	54
8.8.2	ACE_MCO.1 Konsistenz des PP-Moduls.....	54
8.9	Konsistenz der PP-Konfiguration (ACE_CCO).....	56
8.9.1	Ziele .....	56
8.9.2	ACE_CCO.1 Konsistenz der PP-Konfiguration.....	56

9	Klasse ASE: Evaluierung der Sicherheitsvorgabe (ST)	60
9.1	Allgemeines	60
9.2	ST-Einleitung (ASE_INT)	60
9.2.1	Ziele	60
9.2.2	ASE_INT.1 ST-Einleitung	60
9.3	Konformitätsansprüche (ASE_CCL)	62
9.3.1	Ziele	62
9.3.2	ASE_CCL.1 Konformitätsansprüche	62
9.4	Sicherheitsproblemdefinition (ASE_SPD)	64
9.4.1	Ziele	64
9.4.2	ASE_SPD.1 Sicherheitsproblemdefinition	64
9.5	Sicherheitszielsetzungen (ASE_OBJ)	65
9.5.1	Ziele	65
9.5.2	Komponentenebenen	65
9.5.3	ASE_OBJ.1 Sicherheitszielsetzungen für die Betriebsumgebung	65
9.5.4	ASE_OBJ.2 Sicherheitszielsetzungen	66
9.6	Erweiterte Komponentendefinition (ASE_ECD)	67
9.6.1	Ziele	67
9.6.2	ASE_ECD.1 Erweiterte Komponentendefinition	67
9.7	Sicherheitsanforderungen (ASE_REQ)	68
9.7.1	Ziele	68
9.7.2	Komponentenebenen	68
9.7.3	ASE_REQ.1 Direkte Begründung für die Sicherheitsanforderungen	68
9.7.4	ASE_REQ.2 Abgeleitete Sicherheitsanforderungen	70
9.8	Zusammenfassende Spezifikation des TOE (ASE_TSS)	71
9.8.1	Ziele	71
9.8.2	Komponentenebenen	72
9.8.3	ASE_TSS.1 Zusammenfassende Spezifikation des TOE	72
9.8.4	ASE_TSS.2 Zusammenfassende Spezifikation des TOE mit zusammenfassendem Architekturdesign	72
9.9	Konsistenz der Sicherheitsvorgaben des Verbundprodukts (ASE_COMP)	73
9.9.1	Ziele	73
9.9.2	Komponentenebenen	73
9.9.3	Anwendungshinweise	73
9.9.4	ASE_COMP.1 Konsistenz der Sicherheitsvorgabe (ST)	75
10	Klasse ADV: Entwicklung	76
10.1	Allgemeines	76
10.2	Sicherheitsarchitektur (ADV_ARC)	81
10.2.1	Ziele	81
10.2.2	Komponentenebenen	81
10.2.3	Anwendungshinweise	81
10.2.4	ADV_ARC.1 Beschreibung der Sicherheitsarchitektur	82
10.3	Funktionsspezifikation (ADV_FSP)	83
10.3.1	Ziele	83
10.3.2	Komponentenebenen	83
10.3.3	Anwendungshinweise	83
10.3.4	ADV_FSP.1 Grundlegende Funktionsanforderungen	86
10.3.5	ADV_FSP.2 Sicherheit durchsetzende Funktionsspezifikation	87
10.3.6	ADV_FSP.3 Funktionsspezifikation mit vollständiger Zusammenfassung	88
10.3.7	ADV_FSP.4 Vollständige Funktionsspezifikation	89
10.3.8	ADV_FSP.5 Vollständige semiformale Funktionsspezifikation mit zusätzlichen Fehlerinformationen	90
10.3.9	ADV_FSP.6 Vollständige semiformale Funktionsspezifikation mit zusätzlicher formaler Spezifikation	91
10.4	Darstellung der Implementierung (ADV_IMP)	93
10.4.1	Ziele	93
10.4.2	Komponentenebenen	93

10.4.3	Anwendungshinweise.....	93
10.4.4	ADV_IMP.1 Darstellung der Implementierung der TSF .....	94
10.4.5	ADV_IMP.2 Vollständige Zuordnung der Darstellung der Implementierung der TSF.....	95
10.5	TSF-Interna (ADV_INT).....	96
10.5.1	Ziele .....	96
10.5.2	Komponentenebenen .....	96
10.5.3	Anwendungshinweise.....	96
10.5.4	ADV_INT.1 Wohlstrukturierte Teilmengen von TSF-Interna.....	97
10.5.5	ADV_INT.2 Wohlstrukturierte Interna .....	98
10.5.6	ADV_INT.3 Minimal komplexe Interna.....	99
10.6	Modellierung der Sicherheitspolitik (ADV_SPM).....	100
10.6.1	Ziele .....	100
10.6.2	Komponentenebenen .....	100
10.6.3	Anwendungshinweise.....	100
10.6.4	ADV_SPM.1 Formales TOE-Sicherheitspolitikmodell .....	101
10.7	TOE-Design (ADV_TDS).....	103
10.7.1	Ziele .....	103
10.7.2	Komponentenebenen .....	103
10.7.3	Anwendungshinweise.....	103
10.7.4	ADV_TDS.1 Grundsätzliches Design .....	105
10.7.5	ADV_TDS.2 Architekturdesign .....	106
10.7.6	ADV_TDS.3 Grundsätzliches modulares Design .....	107
10.7.7	ADV_TDS.4 Semiformales modulares Design .....	108
10.7.8	ADV_TDS.5 Vollständiges semiformales modulares Design.....	110
10.7.9	ADV_TDS.6 Vollständiges semiformales modulares Design mit formaler allgemeiner Designarstellung.....	111
10.8	Compliance mit dem Verbunddesign (ADV_COMP).....	113
10.8.1	Ziele .....	113
10.8.2	Komponentenebenen .....	113
10.8.3	Anwendungshinweise.....	113
10.8.4	ADV_COMP.1 Design-Compliance mit den basiskomponentenbezogenen Leitlinien für Benutzer, dem ETR für Verbundevaluierung und dem Bericht der Evaluierungsinstanz der Basiskomponente.....	114
11	Klasse AGD: Leitliniendokumente .....	114
11.1	Allgemeines.....	114
11.2	Operative Leitlinien für Benutzer (AGD_OPE) .....	115
11.2.1	Ziele .....	115
11.2.2	Komponentenebenen .....	115
11.2.3	Anwendungshinweise.....	115
11.2.4	AGD_OPE.1 Operative Leitlinien für Benutzer .....	116
11.3	Vorbereitende Verfahren (AGD_PRE).....	117
11.3.1	Ziele .....	117
11.3.2	Komponentenebenen .....	117
11.3.3	Anwendungshinweise.....	117
11.3.4	AGD_PRE.1 Vorbereitende Verfahren.....	118
12	Klasse ALC: Unterstützung des Lebenszyklus .....	118
12.1	Allgemeines.....	118
12.2	CM-Funktionen (ALC_CMC).....	120
12.2.1	Ziele .....	120
12.2.2	Komponentenebenen .....	120
12.2.3	Anwendungshinweise.....	121
12.2.4	ALC_CMC.1 Kennzeichnung des TOE.....	121
12.2.5	ALC_CMC.2 Verwendung des CM-Systems.....	122
12.2.6	ALC_CMC.3 Autorisierungskontrollen .....	123
12.2.7	ALC_CMC.4 Herstellungsunterstützung, Abnahmeverfahren und Automatisierung.....	125
12.2.8	ALC_CMC.5 Erweiterte Unterstützung .....	128
12.3	CM-Umfang (ALC_CMS) .....	132

12.3.1	Ziele .....	132
12.3.2	Komponentenebenen.....	132
12.3.3	Anwendungshinweise.....	132
12.3.4	ALC_CMS.1 CM-Abdeckung des TOE.....	132
12.3.5	ALC_CMS.2 CM-Abdeckung für Teile des TOE .....	133
12.3.6	ALC_CMS.3 CM-Abdeckung für die Darstellung der Implementierung.....	134
12.3.7	ALC_CMS.4 CM-Abdeckung für die Problemverfolgung.....	135
12.3.8	ALC_CMS.5 CM-Abdeckung für Entwicklungswerkzeuge .....	136
12.4	Lieferung (ALC_DEL).....	137
12.4.1	Ziele .....	137
12.4.2	Komponentenebenen.....	137
12.4.3	Anwendungshinweise.....	137
12.4.4	ALC_DEL.1 Lieferverfahren .....	138
12.5	Sicherheit in der Entwicklungsumgebung (ALC_DVS).....	138
12.5.1	Ziele .....	138
12.5.2	Komponentenebenen.....	138
12.5.3	Anwendungshinweise.....	138
12.5.4	ALC_DVS.1 Identifikation von Sicherheitsmaßnahmen .....	139
12.5.5	ALC_DVS.2 Angemessenheit von Sicherheitsmaßnahmen.....	139
12.6	Mängelbeseitigung (ALC_FLR).....	140
12.6.1	Ziele .....	140
12.6.2	Komponentenebenen.....	140
12.6.3	Anwendungshinweise.....	140
12.6.4	ALC_FLR.1 Grundlegende Mängelbeseitigung.....	141
12.6.5	ALC_FLR.2 Verfahren zu Mängelberichten .....	142
12.6.6	ALC_FLR.3 Systematische Mängelbeseitigung.....	143
12.7	Entwicklung des Lebenszyklus (ALC_LCD).....	145
12.7.1	Ziele .....	145
12.7.2	Komponentenebenen.....	145
12.7.3	Anwendungshinweise.....	145
12.7.4	ALC_LCD.1 Vom Entwickler definierte Lebenszyklusprozesse.....	146
12.7.5	ALC_LCD.2 Messbares Lebenszyklusmodell.....	147
12.8	Artefakte der TOE-Entwicklung (ALC_TDA).....	148
12.8.1	Ziele .....	148
12.8.2	Komponentenebenen.....	148
12.8.3	Anwendungshinweise.....	149
12.8.4	ALC_TDA.1 Eindeutig identifizierende Implementierungsrepräsentation .....	149
12.8.5	ALC_TDA.2 Abgleich des Umfangs der Darstellung der Implementierung mit dem CMS.....	151
12.8.6	ALC_TDA.3 Neugenerierung des TOE mit genau definierten Entwicklungswerkzeugen .....	154
12.9	Werkzeuge und Techniken (ALC_TAT).....	157
12.9.1	Ziele .....	157
12.9.2	Komponentenebenen.....	157
12.9.3	Anwendungshinweise.....	158
12.9.4	ALC_TAT.1 Genau festgelegte Entwicklungswerkzeuge.....	158
12.9.5	ALC_TAT.2 Konformität mit Implementierungsstandards .....	159
12.9.6	ALC_TAT.3 Konformität mit Implementierungsstandards - alle Teile .....	160
12.10	Integration von Zusammensetzungs- und Konsistenzprüfung von Lieferverfahren (ALC_COMP).....	161
12.10.1	Ziele .....	161
12.10.2	Komponentenebenen.....	161
12.10.3	Anwendungshinweise.....	161
12.10.4	ALC_COMP.1 Integration der abhängigen Komponente in die zugehörige Basiskomponente und Konsistenzprüfung für Auslieferungs- und Abnahmeverfahren.....	161
13	Klasse ATE: Prüfungen.....	162
13.1	Allgemeines.....	162
13.2	Abdeckung (ATE_COV) .....	163
13.2.1	Ziele .....	163

13.2.2	Komponentenebenen .....	163
13.2.3	Anwendungshinweise.....	163
13.2.4	ATE_COV.1 Nachweis der Abdeckung .....	163
13.2.5	ATE_COV.2 Analyse der Abdeckung.....	164
13.2.6	ATE_COV.3 Strenge Analyse der Abdeckung.....	165
13.3	Tiefe (ATE_DPT).....	166
13.3.1	Ziele .....	166
13.3.2	Komponentenebenen .....	166
13.3.3	Anwendungshinweise.....	166
13.3.4	ATE_DPT.1 Prüfung: grundlegendes Design.....	166
13.3.5	ATE_DPT.2 Prüfung: Sicherheit-durchsetzende Module .....	167
13.3.6	ATE_DPT.3 Prüfung: modulares Design .....	168
13.3.7	ATE_DPT.4 Prüfung: Darstellung der Implementierung .....	169
13.4	Funktionsprüfungen (ATE_FUN) .....	170
13.4.1	Ziele .....	170
13.4.2	Komponentenebenen .....	170
13.4.3	Anwendungshinweise.....	170
13.4.4	ATE_FUN.1 Funktionsprüfung.....	170
13.4.5	ATE_FUN.2 Geordnete Funktionsprüfungen.....	171
13.5	Unabhängiges Prüfen (ATE_IND).....	172
13.5.1	Ziele .....	172
13.5.2	Komponentenebenen .....	172
13.5.3	Anwendungshinweise.....	173
13.5.4	ATE_IND.1 Unabhängige Prüfungen - Konformität.....	173
13.5.5	ATE_IND.2 Unabhängige Prüfungen - Stichprobe.....	174
13.5.6	ATE_IND.3 Unabhängige Prüfungen - vollständig .....	175
13.6	Prüfung von Verbundprodukten (ATE_COMP) .....	177
13.6.1	Ziele .....	177
13.6.2	Komponentenebenen .....	177
13.6.3	Anwendungshinweise.....	177
13.6.4	ATE_COMP.1 Funktionsprüfung des Verbundprodukts.....	178
14	Klasse AVA: Anfälligkeitsbewertung.....	178
14.1	Allgemeines.....	178
14.2	Anwendungshinweise.....	179
14.3	Anfälligkeitsanalyse (AVA_VAN) .....	179
14.3.1	Ziele .....	179
14.3.2	Komponentenebenen .....	179
14.3.3	AVA_VAN.1 Anfälligkeitsuntersuchung.....	180
14.3.4	AVA_VAN.2 Anfälligkeitsanalyse .....	180
14.3.5	AVA_VAN.3 Konzentrierte Anfälligkeitsanalyse.....	182
14.3.6	AVA_VAN.4 Methodische Anfälligkeitsanalyse .....	183
14.3.7	AVA_VAN.5 Erweiterte methodische Anfälligkeitsanalyse .....	184
14.4	Anfälligkeitsbewertung für Verbundprodukte (AVA_COMP) .....	186
14.4.1	Ziele .....	186
14.4.2	Komponentenebenen .....	186
14.4.3	Anwendungshinweise.....	186
14.4.4	AVA_COMP.1 Anfälligkeitsbewertung für Verbundprodukte .....	187
15	Klasse ACO: Zusammensetzung.....	187
15.1	Allgemeines.....	187
15.2	Begründung der Zusammensetzung (ACO_COR).....	190
15.2.1	Ziele .....	190
15.2.2	Komponentenebenen .....	190
15.2.3	ACO_COR.1 Begründung der Zusammensetzung.....	190
15.3	Entwicklungsnachweis (ACO_DEV).....	191
15.3.1	Ziele .....	191
15.3.2	Komponentenebenen .....	191
15.3.3	Anwendungshinweise.....	191

15.3.4	ACO_DEV.1 Funktionsbeschreibung.....	192
15.3.5	ACO_DEV.2 Einfacher Nachweis des Designs .....	193
15.3.6	ACO_DEV.3 Detaillierter Nachweis des Designs.....	194
15.4	Verlässlichkeit der abhängigen Komponente (ACO_REL) .....	195
15.4.1	Ziele .....	195
15.4.2	Komponentenebenen.....	195
15.4.3	Anwendungshinweise .....	195
15.4.4	ACO_REL.1 Einfache Verlässlichkeitsinformation .....	195
15.4.5	ACO_REL.2 Verlässlichkeitsinformationen .....	196
15.5	Prüfen des zusammengesetzten TOEs (ACO_CTT).....	197
15.5.1	Ziele .....	197
15.5.2	Komponentenebenen.....	197
15.5.3	Anwendungshinweise .....	197
15.5.4	ACO_CTT.1 Schnittstellenprüfung .....	198
15.5.5	ACO_CTT.2 Strenge Schnittstellenprüfung .....	199
15.6	Anfälligkeitsanalyse der Zusammensetzung (ACO_VUL).....	200
15.6.1	Ziele .....	200
15.6.2	Komponentenebenen.....	201
15.6.3	Anwendungshinweise .....	201
15.6.4	ACO_VUL.1 Anfälligkeitsüberprüfung der Zusammensetzung .....	201
15.6.5	ACO_VUL.2 Anfälligkeitsanalyse der Zusammensetzung.....	202
15.6.6	ACO_VUL.3 Erweitert-einfache Anfälligkeitsanalyse der Zusammensetzung.....	203
<b>Anhang A (informativ) Entwicklung (ADV) .....</b>		<b>205</b>
A.1	Ergänzende Informationen zu ADV_ARC: Sicherheitsarchitekturen .....	205
A.1.1	Allgemeines .....	205
A.1.2	Sicherheitsarchitektureigenschaften .....	205
A.1.3	Sicherheitsarchitekturbeschreibungen.....	206
A.2	ADV_FSP: Ergänzende Informationen zur Funktionsspezifikation .....	209
A.2.1	Allgemeines .....	209
A.2.2	Nicht-TSF-Teil des TOE .....	209
A.2.3	Bestimmen der TSFI .....	210
A.2.4	Beispiel: Ein komplexes DBMS.....	213
A.2.5	Beispiel-Funktionsspezifikation .....	214
A.3	ADV_INT: Ergänzende Informationen zu TSF-Interna .....	217
A.3.1	Allgemeines .....	217
A.3.2	Struktur von prozeduraler Software .....	217
A.3.3	Komplexität von prozeduraler Software .....	219
A.4	ADV_TDS: Teilsysteme und Module.....	219
A.4.1	Allgemeines .....	219
A.4.2	Teilsysteme .....	220
A.4.3	Module .....	221
A.4.4	Ansatz zur Einstufung .....	223
A.4.5	Sicherheitsrelevanz .....	225
A.5	Ergänzende Informationen zu formalen Methoden.....	226
<b>Anhang B (informativ) Zusammensetzung (ACO) .....</b>		<b>228</b>
B.1	Allgemeines .....	228
B.2	Notwendigkeit für Evaluierungen zusammengesetzter TOEs .....	228
B.3	Durchführung der Evaluierung von Sicherheitsvorgaben (ST) für einen zusammengesetzten TOE.....	230
B.4	Interaktionen zwischen zusammengesetzten IT-Entitäten.....	230
<b>Anhang C (informativ) Querverweisung von Abhängigkeiten der Vertrauenswürdigkeitskomponenten.....</b>		<b>236</b>
<b>Literaturhinweise .....</b>		<b>242</b>

## Bilder

Bild 1 — Hierarchie von Vertrauenswürdigkeitsklasse/-familie/-komponente/-element .....	28
Bild 2 — Struktur der Vertrauenswürdigkeitskomponenten .....	29
Bild 3 — Muster eines Klassenaufbaudiagramms.....	32
Bild 4 — APE: Evaluierung des Schutzprofils (PP), Klassenaufbau .....	32
Bild 5 — ACE: Evaluierung der Schutzprofilkonfiguration, Klassenaufbau.....	43
Bild 6 — ASE: Evaluierung der Sicherheitsvorgabe (ST), Klassenaufbau.....	60
Bild 7 — Beziehungen von ADV-Konstrukten zueinander und zu anderen Familien .....	77
Bild 8 — ADV: Entwicklung, Klassenaufbau .....	80
Bild 9 — AGD: Leitliniendokumente, Klassenaufbau .....	115
Bild 10 — ALC: Unterstützung des Lebenszyklus, Klassenaufbau .....	120
Bild 11 — ATE: Prüfungen, Klassenaufbau.....	163
Bild 12 — AVA: Anfälligkeitsbewertung, Klassenaufbau .....	178
Bild 13 — Beziehung zwischen ACO-Familien und Interaktionen zwischen den Komponenten.....	188
Bild 14 — Beziehung zwischen ACO-Familien.....	190
Bild 15 — ACO: Zusammensetzung, Klassenaufbau .....	190
Bild A.1 — Wrapper .....	212
Bild A.2 — Schnittstellen in einem DBMS-System .....	214
Bild A.3 — Teilsysteme und Module .....	220
Bild A.4 — Beziehung von ADV_SPM zu anderen Familien und Konstrukten .....	226
Bild B.1 — Abstraktion der Basiskomponente.....	231
Bild B.2 — Abstraktion der abhängigen Komponente.....	232
Bild B.3 — Abstraktion des zusammengesetzten TOEs.....	233
Bild B.4 — Schnittstellen zusammengesetzter Komponenten.....	233

## Tabellen

Tabelle A.1 — Einstufung der Beschreibungsdetails .....	224
Tabelle C.1 — Abhängigkeitstabelle für Klasse ADV: Entwicklung.....	236
Tabelle C.2 — Abhängigkeitstabelle für Klasse AGD: Leitliniendokumente.....	237

<b>Tabelle C.3 — Abhängigkeitstabelle für Klasse ALC: Unterstützung des Lebenszyklus.....</b>	<b>237</b>
<b>Tabelle C.4 — Abhängigkeitstabelle für Klasse APE: Evaluierung des Schutzprofils.....</b>	<b>238</b>
<b>Tabelle C.5 — Abhängigkeitstabelle für Klasse ACE: Evaluierung der PP-Konfiguration .....</b>	<b>238</b>
<b>Tabelle C.6 — Abhängigkeitstabelle für Klasse ASE: Evaluierung der Sicherheitsvorgabe (ST).....</b>	<b>239</b>
<b>Tabelle C.7 — Abhängigkeitstabelle für Klasse ATE: Prüfungen .....</b>	<b>239</b>
<b>Tabelle C.8 — Abhängigkeitstabelle für Klasse AVA: Anfälligkeitsbewertung .....</b>	<b>240</b>
<b>Tabelle C.9 — Abhängigkeitstabelle für Klasse ACO: Zusammensetzung.....</b>	<b>240</b>